

ELITE™ 5400GS

Enhanced Polyethylene Resin

概述

ELITE™

5400GS增强聚乙烯树脂是采用陶氏INSITE™技术生产的共聚物，它具有极佳的耐冲击性能，兼具优秀的抗撕裂、抗拉性能以及光学性能，可用于制造高强度的吹塑薄膜。此外ELITE™ 5400GS增强聚乙烯树脂还集合了低始封温度、较高模数和更不易阻塞等独特性能，可用于自动包装。

用途：

- 食品和专用包装膜。
- 极高的耐冲击性能。
- 优秀的抗撕裂、抗拉性能以及光学性能。
- 低始封温度、高热粘性强度，可用于制袋—充填—封口用途。

符合：

- 欧盟No 10/2011 法规
- 美国FDA FCN 424
- 查看法规了解完整的信息

添加剂

- 抗结块剂: No
- 增滑剂: No
- 加工助剂: No

物理性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
密度 / 比重	0.916 g/cm ³	0.916 g/cm ³	ASTM D792
熔融指数 (190°C/2.16 kg)	1.0 g/10 min	1.0 g/10 min	ASTM D1238
薄膜	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
薄膜厚度 - 经测试	2 mil	51 µm	
膜刺穿强度 ¹ (2.0 mil (51 µm))	48.7 in·lb	5.50 J	内部方法
膜刺穿力 ¹ (2.0 mil (51 µm))	24.1 lbf	107 N	内部方法
割线模量 ¹			ASTM D882
1% 正割, MD : 2.0 mil (51 µm)	24800 psi	171 MPa	
1% 正割, TD : 2.0 mil (51 µm)	28100 psi	194 MPa	
抗张强度 ¹			ASTM D882
MD : 屈服, 2.0 mil (51 µm)	1640 psi	11.3 MPa	
TD : 屈服, 2.0 mil (51 µm)	1620 psi	11.2 MPa	
MD : 断裂, 2.0 mil (51 µm)	7830 psi	54.0 MPa	
TD : 断裂, 2.0 mil (51 µm)	7540 psi	52.0 MPa	
伸长率 ¹			ASTM D882
MD : 断裂, 2.0 mil (51 µm)	640 %	640 %	
TD : 断裂, 2.0 mil (51 µm)	660 %	660 %	
落锤冲击 ¹ (2.0 mil (51 µm))	> 850 g	> 850 g	ASTM D1709B
埃尔曼多夫抗撕强度 ²			ASTM D1922
MD : 2.0 mil (51 µm)	630 g	630 g	
TD : 2.0 mil (51 µm)	770 g	770 g	
始封温度 ³ (2.0 mil (51 µm))	194 °F	90.0 °C	内部方法
热性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
熔融温度	252 °F	122 °C	DSC
光学性能	额定值 (英制)	额定值 (公制)	测试方法
光泽度 ¹ (20°, 2.01 mil (51.0 µm))	77	77	ASTM D2457
雾度 ¹ (2.01 mil (51.0 µm))	9.50 %	9.50 %	ASTM D1003
挤出	额定值 (英制)	额定值 (公制)	
熔体温度	374 到 475 °F	190 到 246 °C	



挤压说明

吹塑薄膜挤出的制造条件：

- 模具间隙：0.8-2.8 mm。
- 熔体温度：190-246 °C。
- 放大比：1.5:1 至 3.5:1。

备注

这些仅是典型特性，不能看作是其规格。用户应通过自己测试来验证结果。

¹ 在 232-246°C、2.5:1 BUR、1.9 mm 模具间隙下挤压的吹塑薄膜。

² 类型 A；在 232-246°C、2.5:1 BUR、1.9 mm 模具间隙下挤压的吹塑薄膜。

³ 在 232-246°C、2.5:1 BUR、1.9 mm 模具间隙下挤压的吹塑薄膜。
实现 5.25 N/15 mm 热封强度的温度。

